

本公司的日本总公司---丰田合成株式会社连同欧洲三家公司（Tridonic Jennersdorf GmbH [奥地利]、Leuchtstoffwerk Breitung GmbH [德国]、Litec GbR [德国]）在世界多国申请了以蓝光 LED 芯片与新型黄色荧光粉（硅酸盐系荧光粉）组合得到白光的构造为主的相关专利。目前，在奥地利、欧洲、日本、美国、韩国、台湾、中国、俄罗斯、马来西亚、印度都保有相关专利权。（相关专利，请参照另附的授权专利一览表）

本公司（丰田合成光电贸易（上海）有限公司）经丰田合成株式会社许可，对中国地区的 LED 厂商进行上述相关专利的授权。

目前 本公司已授权厂商如下：

授权厂商
浙江锐迪生光电有限公司
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
深圳市聚飞光电股份有限公司

注意事项

- 1) 该专利授权的公开，并不表示对本公司的总公司---丰田合成股份有限公司拥有的 GaN 系半导体的相关专利进行了授权。

当社の親会社である豊田合成株式会社は、欧州 3 社 (Tridonic Jennersdorf GmbH [オーストリア]、Leuchtstoffwerk Breitung GmbH [ドイツ]、Litec GbR [ドイツ]) と共に青色 LED チップと新規黄色蛍光体 (珪酸塩系蛍光体) により白色光を構成する基本となる特許を多数の国に出願し、現在、オーストリア、欧州、日本、米国、韓国、台湾、中国、ロシア、マレーシア及びインドで特許権を保有しております。(対象特許一覧は、別紙参照)

当社 (豊田合成光電貿易 (上海) 有限公司) は豊田合成株式会社から、中国における LED メーカーに上記対象特許をライセンスする許諾を受けております。

現時点で、当社は、下記中国企業にこれらの特許をライセンスしております <sup>1)</sup>

ライセンシー
Zhejiang Ledison Optoelectronics Co., Ltd.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd.
Shenzhen Jufei Optoelectronics Co., Ltd.

注意事項

- 1) 本特許ライセンス先の開示は、当社の親会社である豊田合成株式会社が保有する GaN 系半導体に関する特許のライセンス先を示すものではありません。

Toyoda Gosei Co., Ltd., which is the parent company of Toyoda Gosei Optoelectronics (Shanghai) Co., Ltd, together with Tridonic Jennersdorf GmbH (Austria), Leuchtstoffwerk Breitung GmbH (Germany), and Litec GbR (Germany), has filed joint applications for basic patents relating to a technology for forming white light using blue LED chips and new yellow (silicate) phosphors. Patent rights have been granted in the Austria, Europe, Japan, U.S.A., Korea, Taiwan, China, Russia, Malaysia, and India. (Please see attached for list of granted patents).

Toyoda Gosei Optoelectronics (Shanghai) Co., Ltd. has been granted the right to license Chinese companies under such patent rights and patent applications from Toyoda Gosei Co., Ltd.

As of the date above, Toyoda Gosei Optoelectronics (Shanghai) Co., Ltd. has licensed these patents to the following Chinese companies [see notes 1]

Licensee
Zhejiang Ledison Optoelectronics Co., Ltd.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd.
Shenzhen Jufei Optoelectronics Co., Ltd.

Notes

- 1) For the purpose of the list above, no other patents, such as patents pertaining to LED chips or LED package design, have been licensed.

Patent List (Patented only)

Nov 6, 2013

Country	Application No.	Publication No.	
		Examined No.	Patent No.
Austria	AT A2154/2000	---	AT410266
Japan	JP2002-0554890	---	JP4048116
	JP2007-023598	---	JP4783306
	JP2002-554891	---	JP4045189
	JP2006-222051	---	JP4583348
USA	US10/250,435	---	US6809347
	US10/974,420	---	US7187011
	US11/499,589	---	US7259396
	US10/451,864	---	US6943380
	US10/952,937	---	US7157746
	US11/087,579	---	US7138660
Europe	US11/606,170	---	US7679101
	EP01027255.1	---	EP1352431
	EP10152099.7	---	EP2211392B1
Russia	EP11155555.3		EP2357678B1
	RU2003123094	---	RU2251761
China	CN01821467.3	CN1268009C	ZL01821467.3
	CN200510086006.6	CN1763982	ZL200510086006.6
	CN01820768.5	CN1291503C	ZL01820768.5
	CN200610142476.4	CN1941441	ZL200610142476.4
Korea	KR10-2003-7007442	---	KR10-0715580
	KR10-2005-7016223	---	KR10-0715579
	KR10-2003-7008704	---	KR10-0532638B
	KR10-2006-7027091	---	KR10-0849766
	KR10-2007-7027069	---	KR10-0867788
India	IN00862/DELNP/2003	---	IN222401B
Malaysia	MY PI20032394	---	MY139538
Taiwan	TW90130309	---	TW I297723B
	TW90132753	TW533604	TW I177666B